

【証券コード：6728】

決算説明会資料

2017年度第2四半期累計 (2017年7月～2017年12月)

2018年2月14日
株式会社 アルバック

◆将来見通しに関する記述についての注意事項

このプレゼンテーション資料で述べられている将来の当社に関する見通しは、現時点で知りうる情報をもとに作成されたものです。当社グループのお客様であるFPD（フラット・パネル・ディスプレイ）・半導体・電子部品などの業界は技術革新のスピードが大変速く、競争の激しい業界です。

また、世界経済、為替レートの変動、FPD・半導体・電子部品・原材料などの市況、設備投資の動向など、当社グループの業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがって、実際の売上高および利益は、このプレゼンテーション資料に記載されている予想数値とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

◆本資料における表示方法について

（特段の記載がない限り、数値はすべて連結ベースです）

数値： 単位未満四捨五入

比率： 百万円単位で計算後、単位未満四捨五入

会計期間の表現：

2Q（累計）： 第2四半期連結累計期間

2Q： 第2四半期連結会計期間

2017年度第2四半期（累計）連結業績概要

□ 受注高 1,463億円（前年同期比 +31%）

- メモリ向け設備投資の増加等を受け、半導体・電子部品製造装置が大幅に増加、FPD・PV製造装置をはじめ、他の品目も前年同期を上回る

□ 売上高 1,253億円（前年同期比 +12%）

- 半導体・電子部品、FPD・PV製造装置を中心に、前年同期を上回る

□ 営業利益 187億円（前年同期比 +30%）

- 各利益項目とも、高水準で推移し、前年同期を上回る

□ 通期業績予想を上方修正

	通期	11月公表値比較
売上高	2,500 億円	(+50 億円)
営業利益	355 億円	(+25 億円)
当期利益	305 億円	(+30 億円)

2017年度2Q（累計）連結業績概要

- 受注高、売上高、各利益項目とも前年同期を上回る
- 売上高は12%増、半導体・電子部品製造装置に加え、FPD製造装置も増加
- 営業利益は30%増、売上高増加が寄与
- 当期純利益は、株式の売却益等も加わり44%増

【単位：億円】

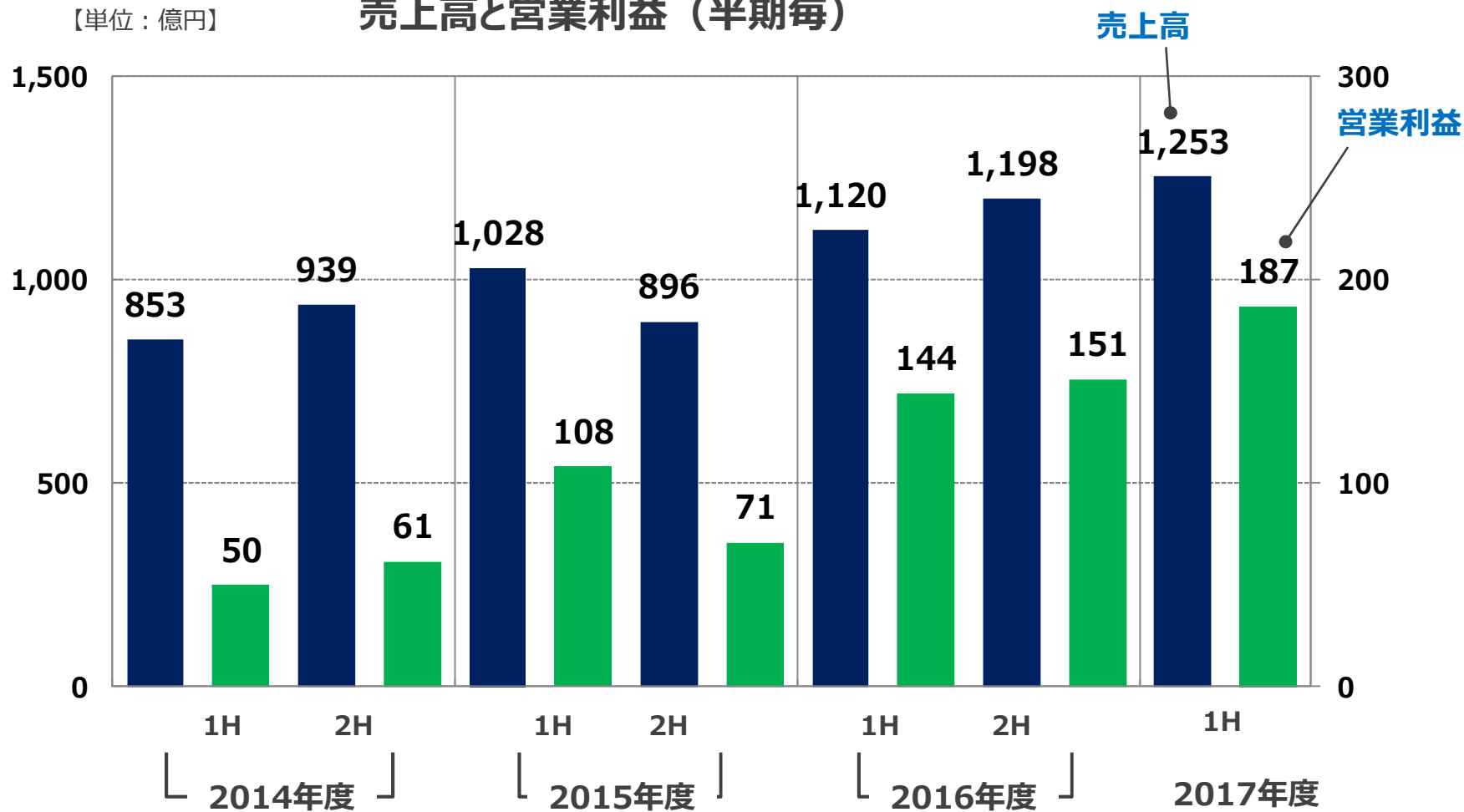
	(参考) 2016年度 上期実績	2017年度2Q（累計）				
		当初予想*1	修正予想*2	実績	対前年同期 増減率	修正予想比 増減率
受注高	1,118	1,400	1,460	1,463	30.9%	0.2%
売上高	1,120	1,150	1,210	1,253	11.8%	3.5%
売上総利益	313	-	-	371	18.6%	-
率	27.9%	-	-	29.6%	+ 1.7 pt	-
販管費	169	-	-	184	9.1%	-
営業利益	144	150	170	187	29.8%	10.0%
率	12.9%	13.0%	14.0%	14.9%	+ 2.1 pt	+ 0.9 pt
経常利益	146	150	170	197	34.3%	15.7%
率	13.1%	13.0%	14.0%	15.7%	+ 2.7 pt	+ 1.6 pt
親会社株主に帰属する 当期純利益	113	115	135	163	44.3%	20.9%
率	10.1%	10.0%	11.2%	13.0%	+ 2.9 pt	+ 1.9 pt

*1：2017年 8月公表値 *2：2017年 11月公表値

2017年度2Q（累計）連結業績概要

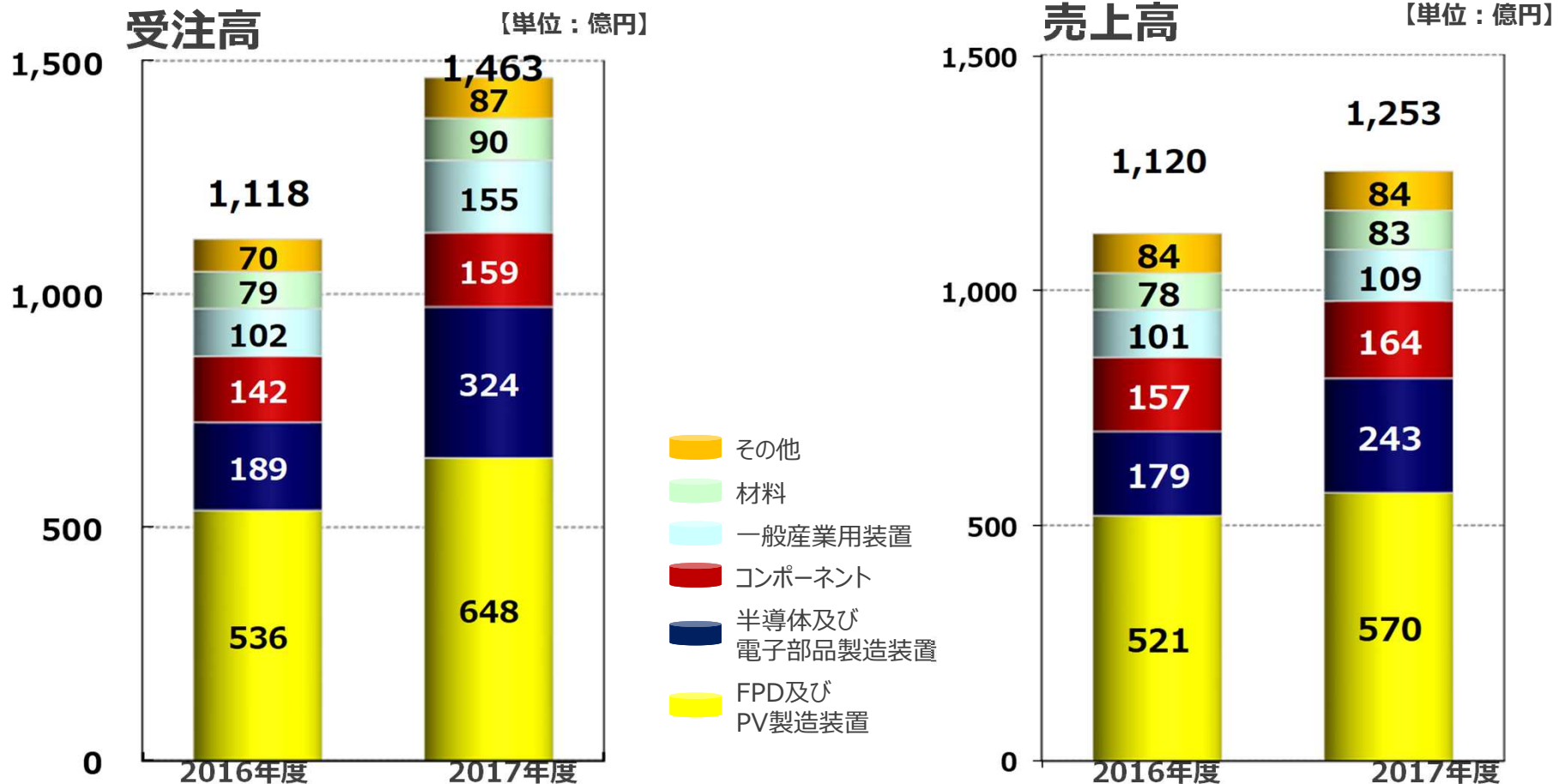
【単位：億円】

売上高と営業利益（半期毎）



2017年度2Q（累計）連結業績概要 （品目別受注高・売上高）

- FPD・PV製造装置：中国を中心に、大型TV向けLCD（液晶）やスマートフォン向けOLED（有機EL）投資が高水準で継続、前年同期を上回る
- 半導体・電子部品製造装置：旺盛なサーバー需要を背景に、メモリ（NAND・DRAM・次世代不揮発性メモリ）向け製造装置が増加。前年同期を大きく上回る

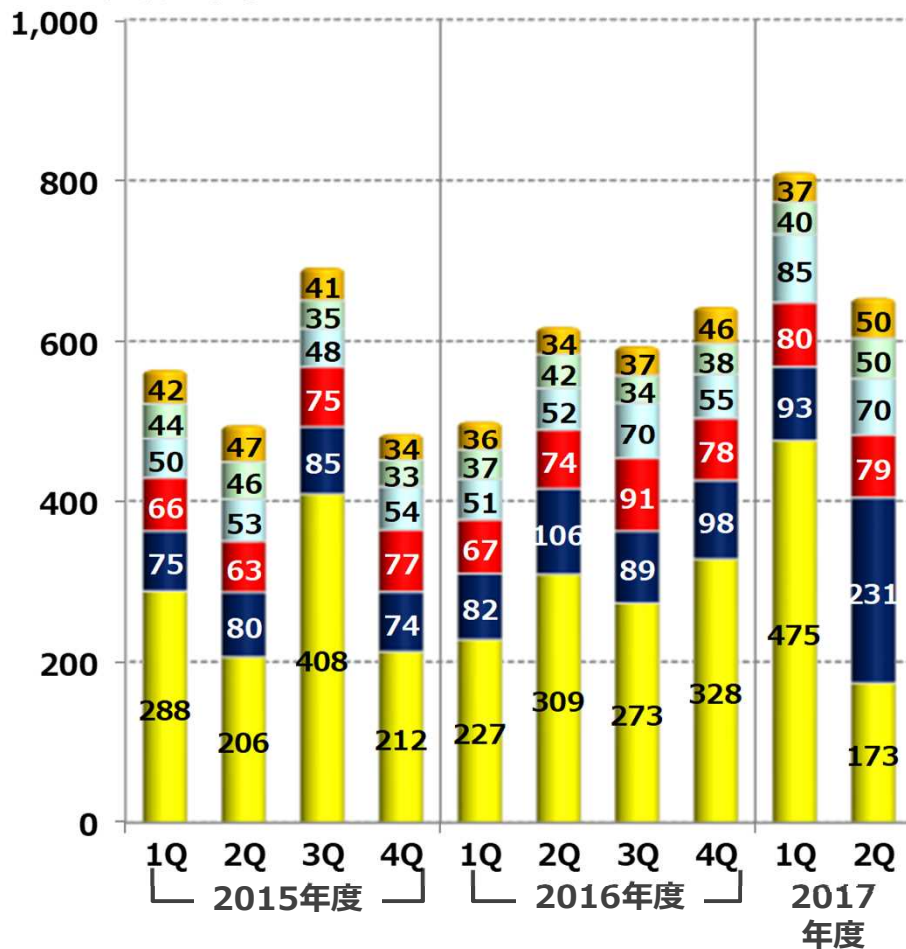


2017年度2Q（累計）連結業績概要 （品目別受注高・売上高：四半期）

・ 受注高、売上高ともに高水準で推移

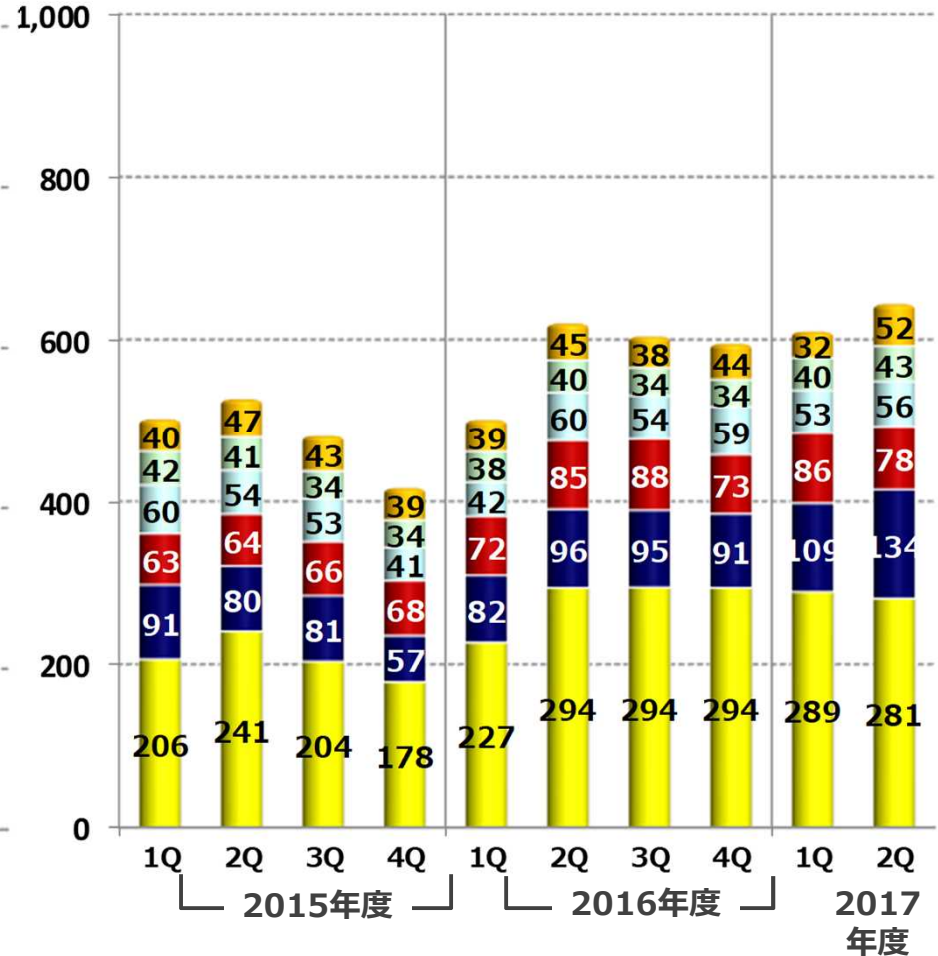
受注高

【単位：億円】



売上高

【単位：億円】

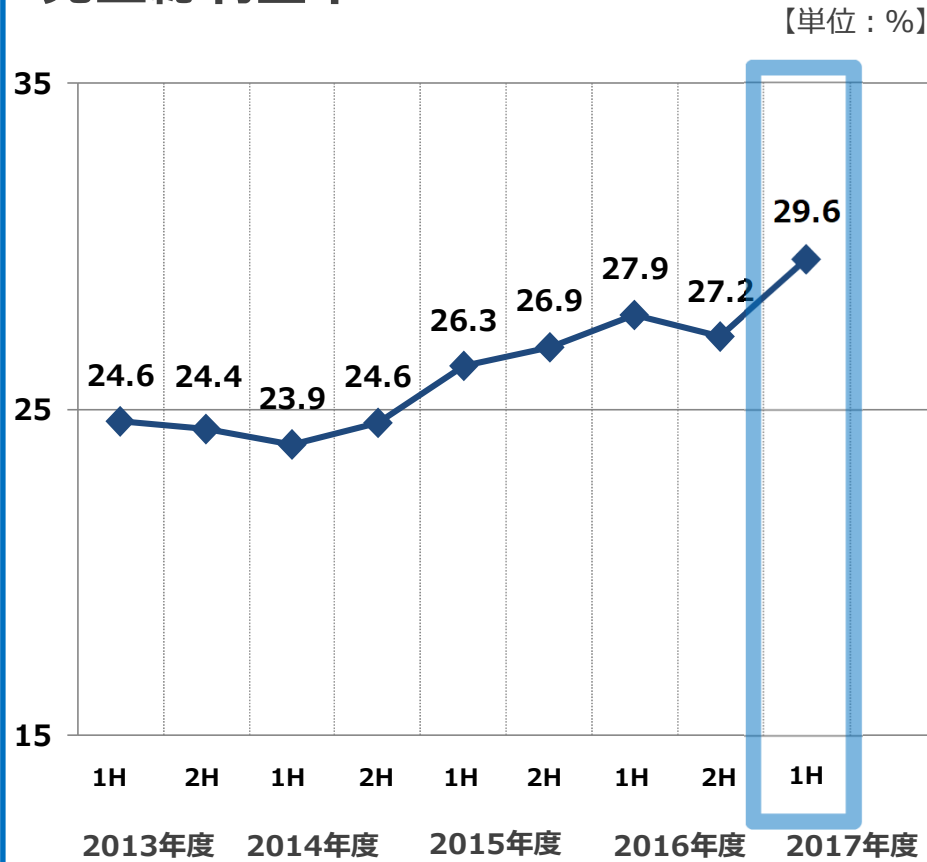


■ FPD及びPV製造装置 ■ 半導体及び電子部品製造装置 ■ コンポーネント
■ 一般産業用装置 ■ 材料 ■ その他

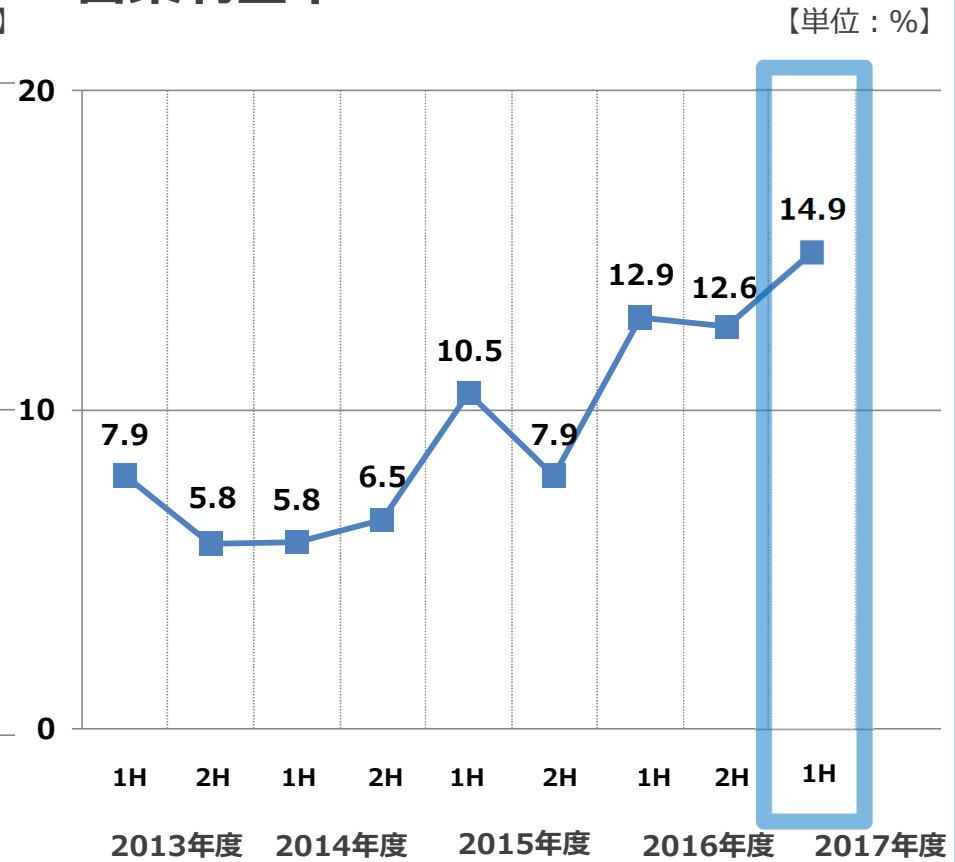
2017年度2Q（累計）連結業績概要 （利益率）

- 売上総利益率、営業利益率とも、高水準で推移

売上総利益率

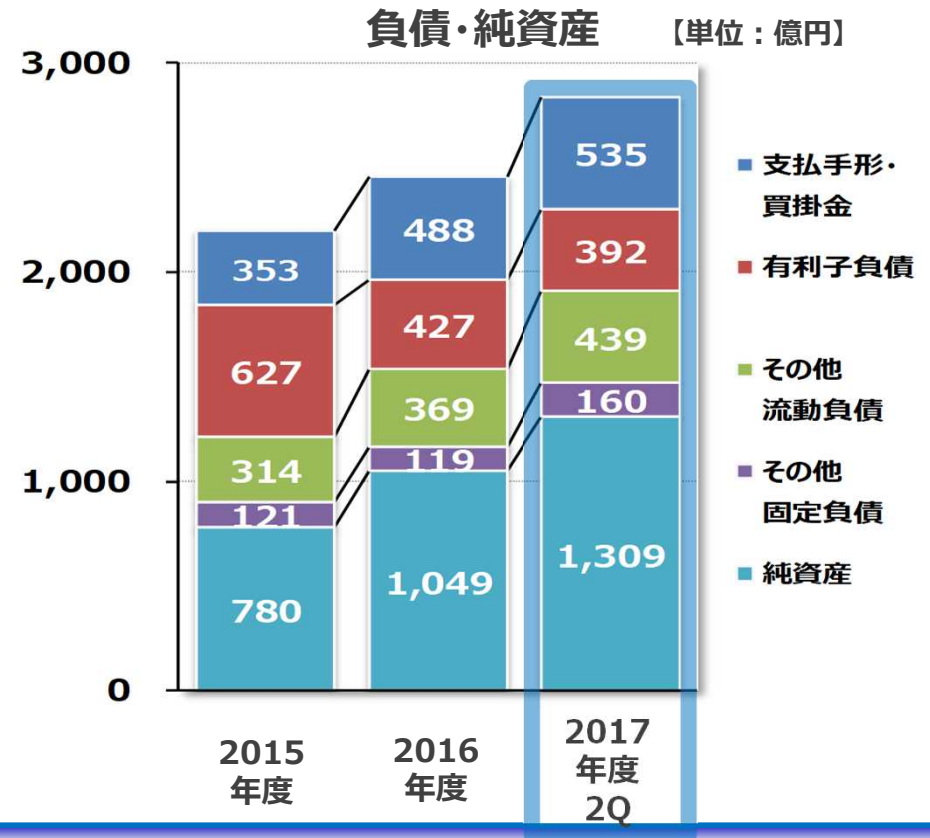
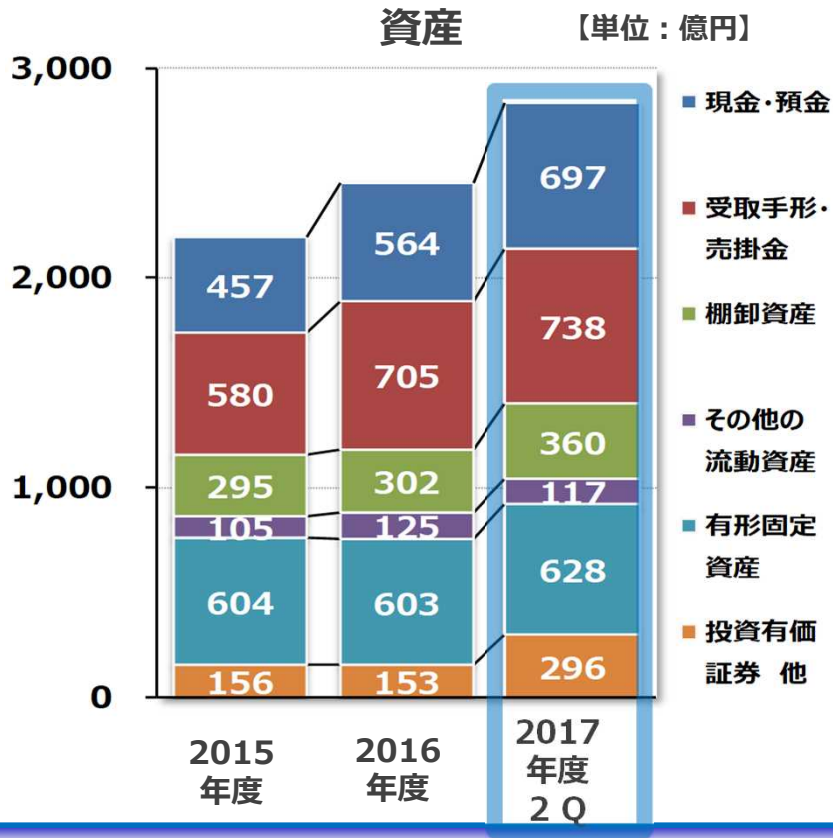


営業利益率



2017年度2Q（累計）連結業績概要 （連結貸借対照表）

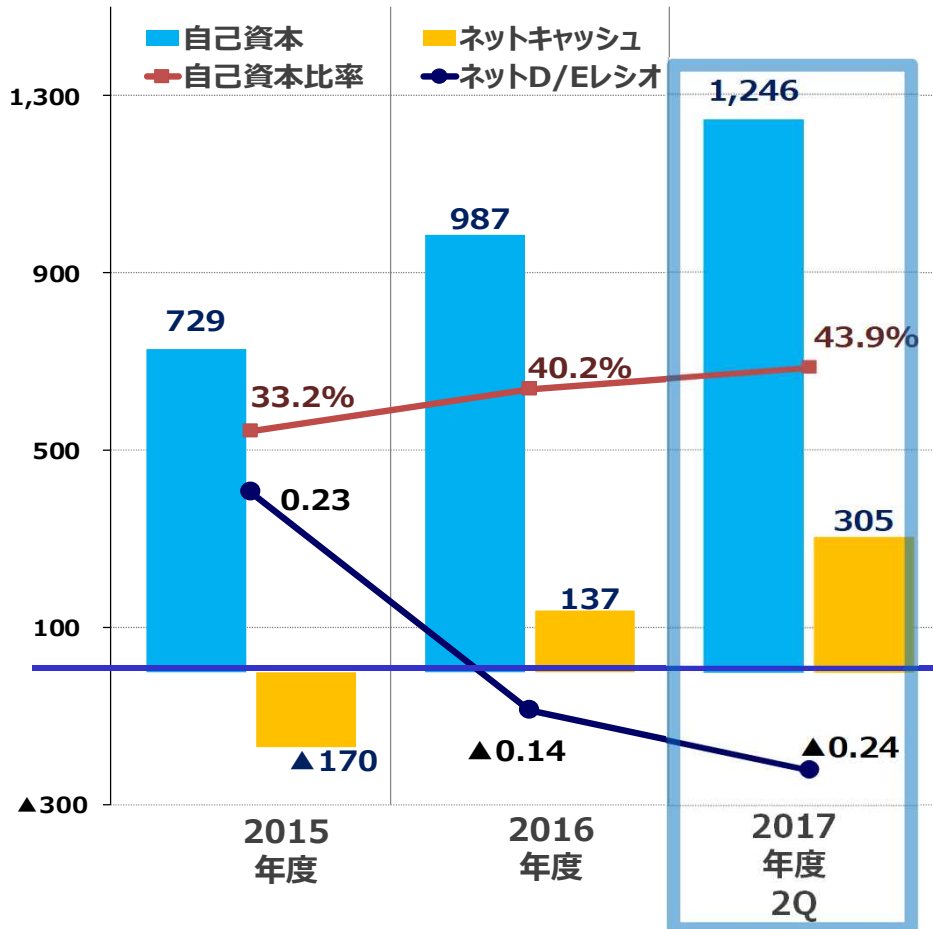
- 受注及び売上増加に伴い、前年度末比で受取手形・売掛金が33億円、棚卸資産が58億円増加。支払手形・買掛金も47億円増加
- 現預金は133億円増加、一方で有利子負債は35億円減少
- 純資産は260億円増加(四半期純利益に加え、投資有価証券の時価評価額の増加による)



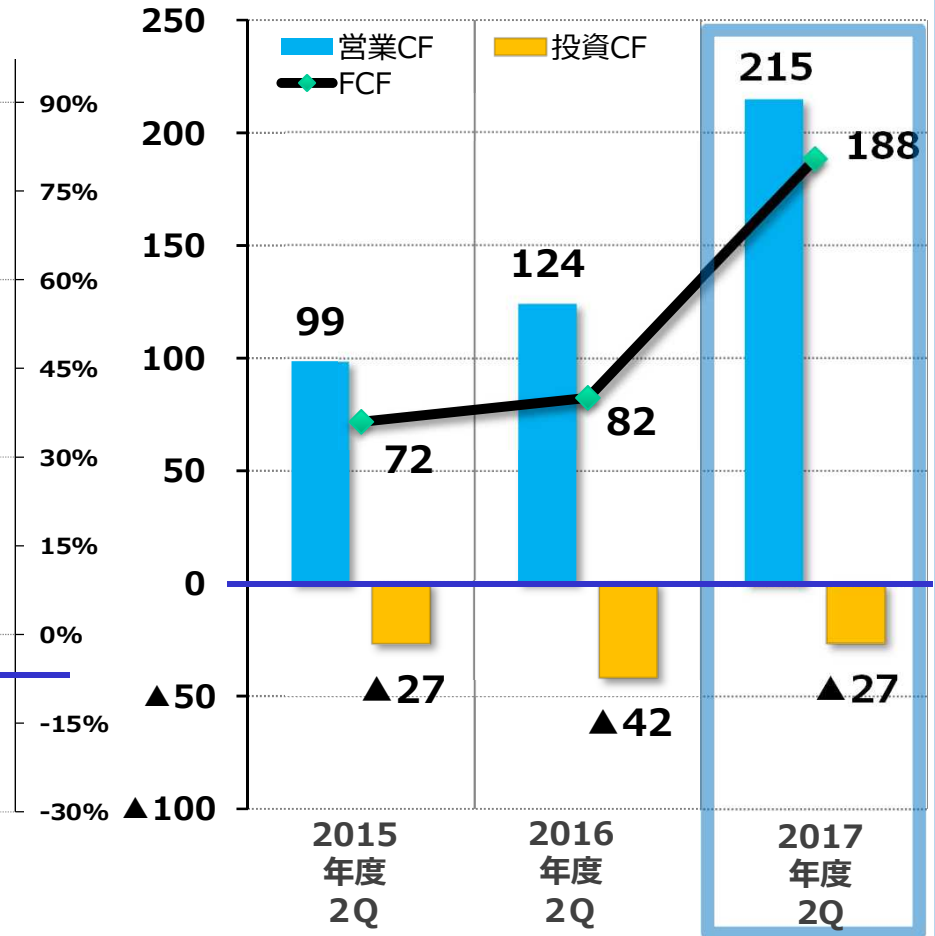
2017年度2Q（累計）連結業績概要 （自己資本、キャッシュ・フロー等）

- 自己資本は1,246億円に増加し、自己資本比率は43.9%にまで改善
ネットキャッシュは305億円に増加し、ネットD/Eレシオが▲0.24にまで改善
- 営業CFは215億円、FCFは188億円

【単位：億円】

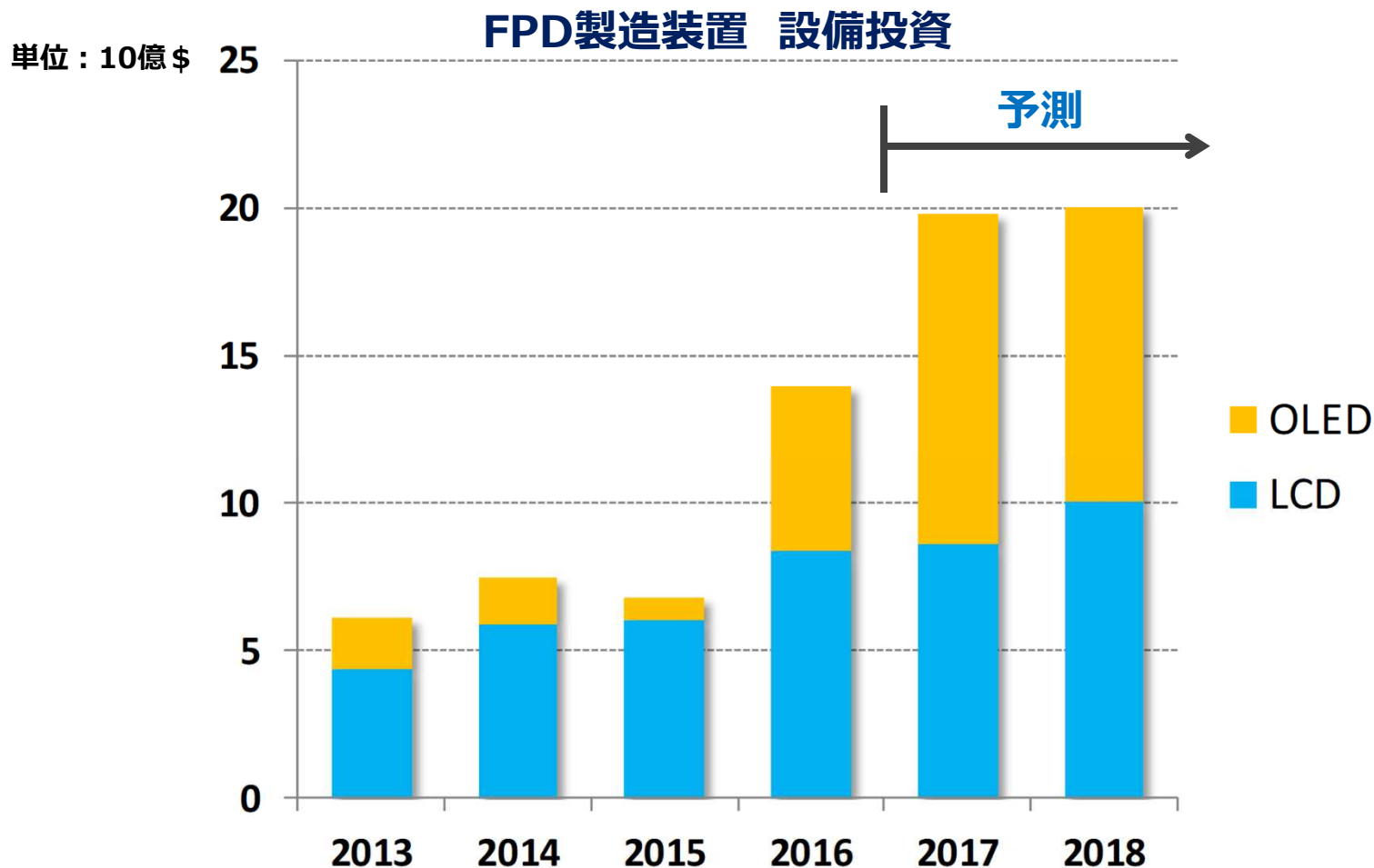


【単位：億円】



事業環境

- 大型TV向けLCDは高水準の投資が継続する見込み
スマートフォン向けOLEDも引き続き旺盛な設備投資が見込まれる



<IHS Markit資料から作成>

- 大型TV向けLCD製造装置：**高水準継続**

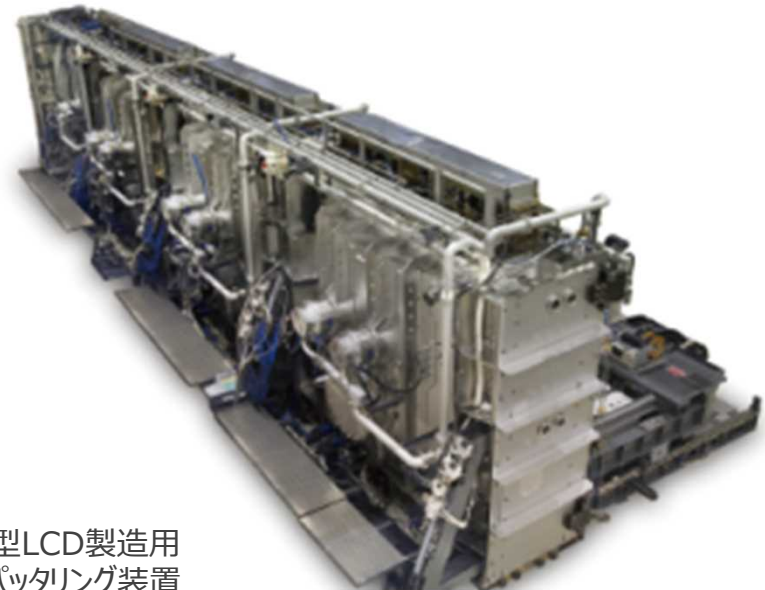
中国を中心に、超大型基板G10.5向けなど旺盛な設備投資が継続(当初想定より前倒し)

→当社の主力製品であるスパッタリング装置の受注拡大

G10.5大型装置で引き続き、100%近いシェアを維持

⇒今後もG10.5を中心に大型TV向け新工場建設を着実に取り込む

大画面化に伴う酸化物半導体への移行も見据え、ターゲット材料も含めたプロセス開発推進



大型LCD製造用
スパッタリング装置
SMDシリーズ

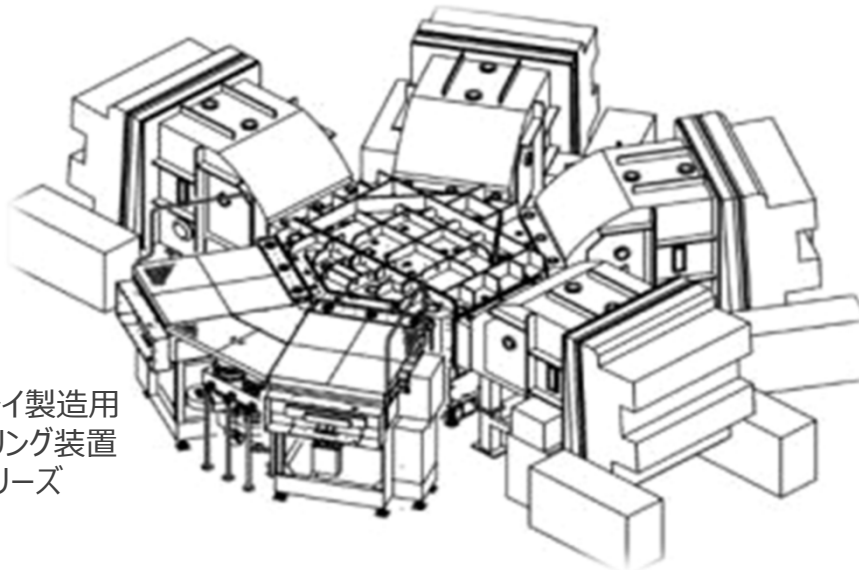
- **中小型OLED製造装置：引き続き旺盛**

OLED搭載プレミアムスマートフォンの売上低調による韓国メーカーの投資に不透明感はあるが、中国での設備投資は引き続き旺盛

→継続受注

(真空蒸着装置、スパッタリング装置、P-CVD装置等)

⇒量産技術の確立をパートナー企業とともに継続中
更なる高精細化に向けた要素技術開発にも注力

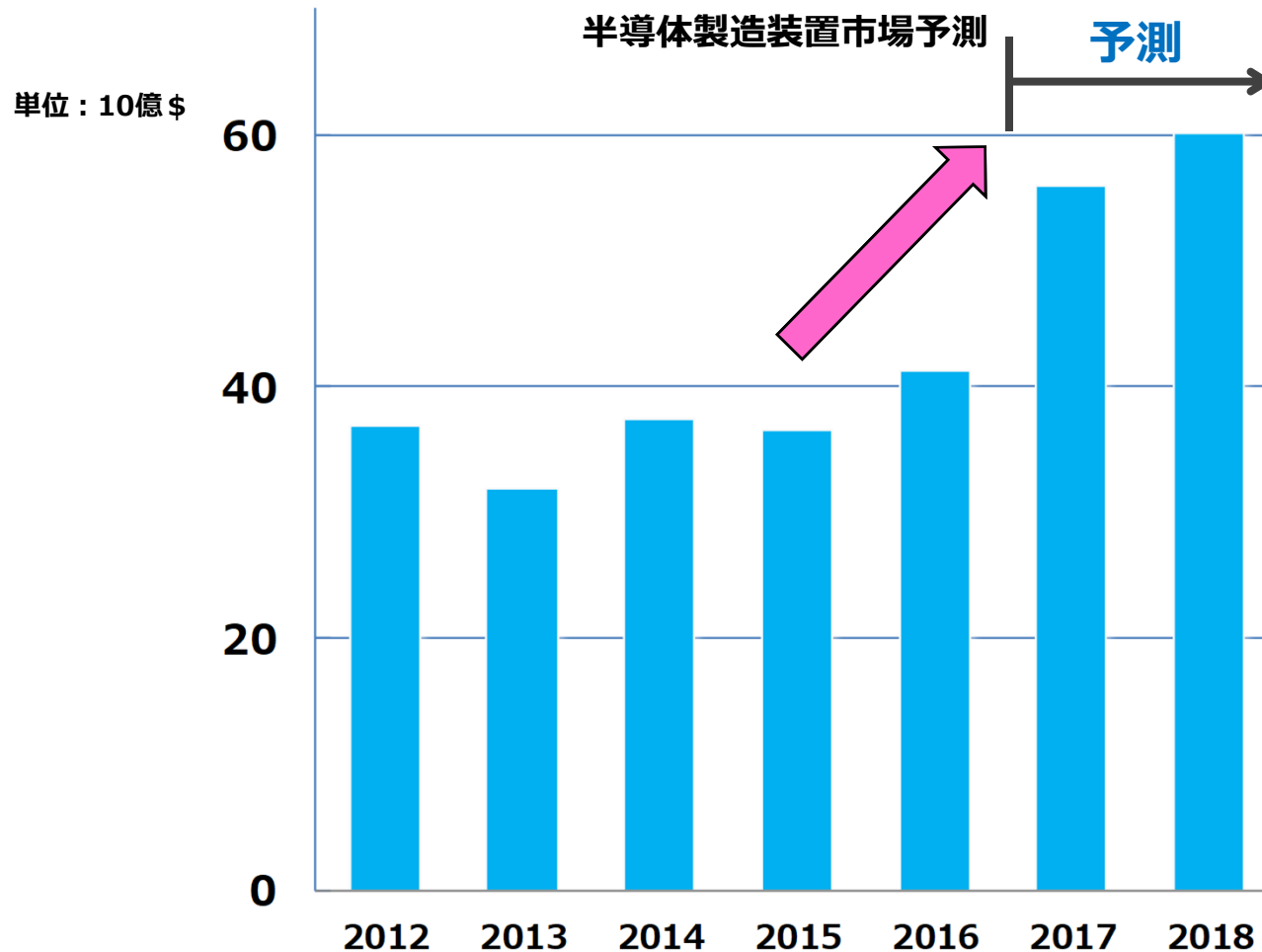


TFTアレイ製造用
スパッタリング装置
SMDシリーズ



OLED製造用
真空蒸着装置
ZELDAシリーズ

- 半導体製造装置市場は、IoTの進展・データ量の増大に伴うサーバー需要の増加等、今後も拡大の見込み



<2017年12月12日SEMI発表「半導体製造装置市場予測」から作成>

- **NAND・DRAM向け：高水準継続**
サーバー向けの旺盛な需要により設備投資は高水準で継続
→メモリメーカー向けにスパッタリング装置や自然酸化膜除去装置を納入
- **次世代不揮発性メモリ：大きく貢献**
PCRAM（相変化メモリ）量産拡大に向けての設備投資旺盛
→スパッタリング装置の需要増加
- **ロジックへの参入：量産化採用に向け評価継続中**
ファブリーメーカーの微細化に向けた開発の進展
→スパッタリング装置を納入し、微細化プロセスの課題解決のための共同開発推進中、
⇒良好な評価を得て、量産ラインに向けた評価継続中
- **中国市場：今後に期待**
実績のある外資系半導体メーカー以外に中国資本のメモリメーカーからも
受注獲得
⇒先端研究機関との連携を深め、更なる事業機会の拡大を推進。



半導体製造用
スパッタリング装置
ENTRON-EX



半導体製造用
自然酸化膜
除去装置
RISE

- **電子デバイス：多様な投資が活況**
スマート社会の進展に伴い、電子デバイスの投資が活況
→通信デバイス・オプトデバイス向けスパッタリング装置
エッチング装置など受注
⇒今後も継続見込み

電子デバイス向け
スパッタリング装置
SMEシリーズ



電子デバイス向け
エッチング装置
NEシリーズ

- **PLP実装：開発段階**
→OSAT等主要客先へ装置納入し、プロセス確立中
⇒今後は、成膜装置やエッチング装置の拡大に期待



PLP実装向け
エッチング装置
NAシリーズ

- **中国市場：今後に期待**
⇒パワーデバイス向け成膜装置やイオン注入装置の拡大に期待



パワーデバイス向け
イオン注入装置
IHシリーズ

2017年度業績予想

2017年度通期連結業績予想

- 好調な上期の実績を受け、通期の売上高、各利益項目とも上方修正
売上高、各利益項目は過去最高を更新の見込み

【単位：億円】

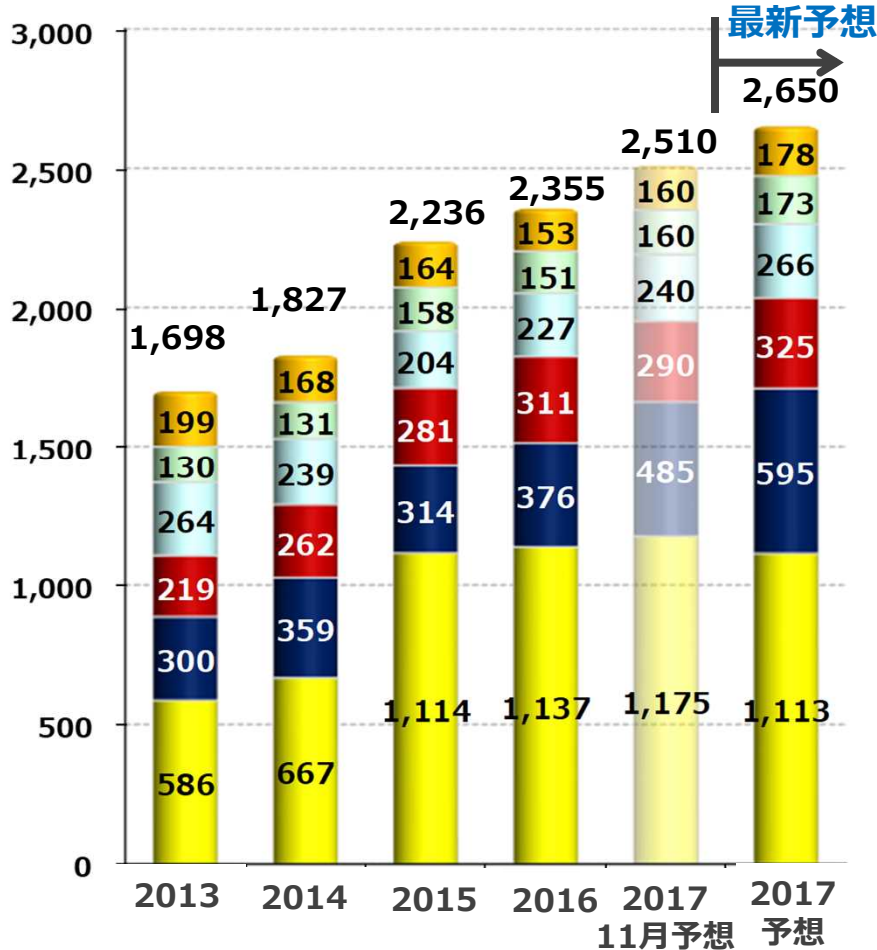
	(参考) 2016年度 通期実績	2017年度			
		2Q累計		通期	
		修正予想*	実績	修正予想*	今回予想
受注高	2,355	1,460	1,463	2,510	2,650
売上高	2,318	1,210	1,253	2,450	2,500
売上総利益	638	-	371	-	735
率	27.5%	-	29.6%	-	29.4%
販管費	344	-	184	-	-
営業利益	295	170	187	330	355
率	12.7%	14.0%	14.9%	13.0%	14.2%
経常利益	297	170	197	330	360
率	12.8%	14.0%	15.7%	13.0%	14.4%
親会社株主に帰属する 当期純利益	245	135	163	275	305
率	10.6%	11.2%	13.0%	10.7%	12.2%

*：2017年11月公表値

2017年度通期連結業績予想 (品目別受注高・売上高)

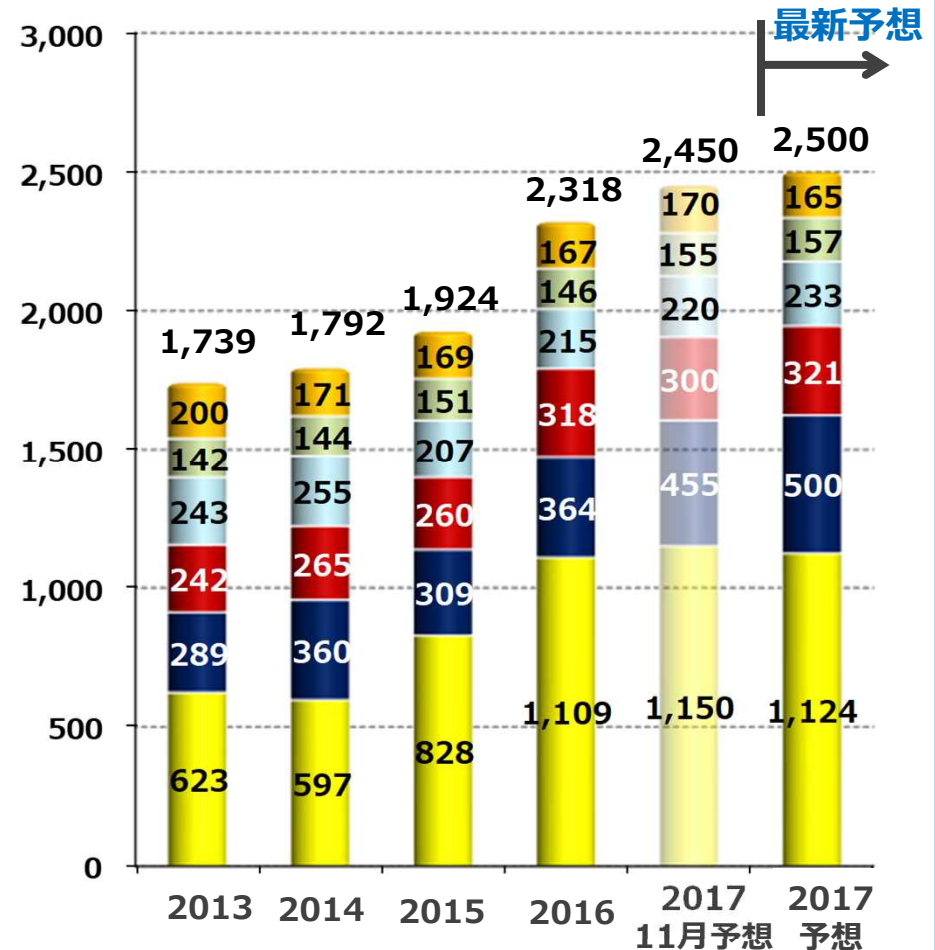
受注高

【単位：億円】

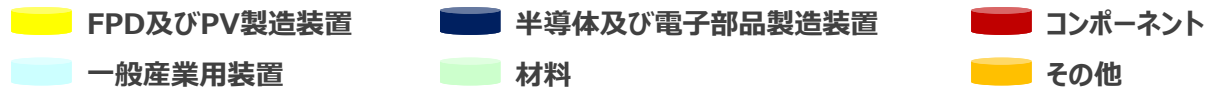


売上高

【単位：億円】



※11月修正予想は、受注高・売上高とも半導体・電子と全体合計をそれぞれ60億円、当初予想比上方修正したものの



真空テクノロジーで
「つくる」をつくる、アルバック
ULVAC